

瑞芯微电子股份有限公司
关于参加 2024 年度沪市主板人工智能专题
集体业绩说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日参加了 2024 年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会，就公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果和财务状况与投资者进行了沟通与交流。现将有关内容公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:00-17:00，公司参加了由上海证券交易所举办的 2024 年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会，公司董事、副总经理兼 CFO 王海闽先生、副总经理李诗勤先生、独立董事乔政先生、董事会秘书林玉秋女士出席会议，与投资者进行现场及线上的互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：

问题 1：以人工智能为首的新一代信息技术快速发展，成为了推动产业变革的重要手段。在这样的背景下，包括在 Agent 方向、端侧落地、智慧城市产业等具体方向都迎来了前所未有的机遇和挑战，我想请问能科科技、瑞芯微、云赛智联三家公司，在各自的领域有什么布局？

回复：随着 AIoT 市场不断发展，接入云端的边、端侧设备数量指数级增长，为应对云端运维成本攀升压力，并满足边、端侧设备对数据隐私保护和低时延、离线运行的需求，大模型规模化落地边、端侧应用的进程正在加速。

公司始终重视 AI 发展，从 2018 年以来持续迭代公司自研的基础 NPU 模块，并结合 AI 技术发展做针对性优化，提升公司产品对 AI 的支持效率；同时，从软

件上提供创新的 AI 算法，向客户展示、引导多样化的 AI 应用解决方案，让 AI 在各种场景、产品中发挥价值，解决产品痛点、难点，提升卖点。目前，公司下游已有多个领域的客户基于瑞芯微主控芯片研发在端侧支持 AI 大模型的新硬件，例如 AI 学习机、AI 玩具、桌面机器人、会议主机、边缘计算等产品。

同时随着 AI 技术不断渗透、应用场景持续拓展，AIoT 市场也在快速增长。针对 AIoT 快速发展机遇，公司将进一步完善产品布局，并计划推出协处理器芯片，解决算力需求快速增长与 SoC 系统级芯片迭代升级周期慢的痛点。协处理器通过与高性能 AIoT SoC 芯片平台配合，可以进一步满足边、端侧设备的 AI 算力升级、运行大模型的需求，助力人工智能技术在各行各业的落地。此外，公司今年重点研发的下一代旗舰芯片也将更契合 AIoT 高端市场的需求，为开启公司新一轮成长周期奠定基础。

问题 2：2024 年 AIoT 市场全面增长，公司如何看待未来 AIoT 市场发展趋势？

回复：我们看到当前国内的 AIoT 百行百业正在蓬勃发展。AI 大模型不断迭代升级、使用效果全面提升，特别是在今年春节期间以 Deepseek 为代表、国内各家头部大模型公司快速迭代的一系列开源大模型（如刚发布的千问 3），同时小参数量、适合端侧部署的模型呈现越来越好的效果。这为边端侧 AI 应用发展带来颠覆性变革。随着 AI 端侧开发门槛显著降低，得益于本地处理的实时性、低网络依赖、隐私保护等优势，AI 技术在汽车、机器人、教育、家庭、医疗等场景，以及可见的工业、农业、服务业等领域加速落地应用，将引发未来可预见的 5-10 年边端侧的 AIoT 高速发展。

公司作为国内 AIoT SoC 领先者，保持长期、稳定、高强度的研发投入，为公司积累了 AIoT 的技术、产品、场景、客户等核心优势。公司为汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居以及消费电子等千行百业的下游客户提供多算力、多层次的 AIoT 芯片平台，拥抱 AIoT 快速发展的全新机遇。

问题 3：中美关系下，对于公司在 AIoT 各领域的份额提升是否是一个契机，公司如何看待国产替代下的机遇？

回复：据我们观察，AIoT 应用大部分在中国。国内在 AIoT 的生态、规模、分工、性能/价格方面有明显的优势，市场空间巨大、增长潜力广阔；而当前国

际形势变化为本土芯片企业全面提升各领域市场份额带来新机遇。公司下游 AIoT 布局近百条产品线，覆盖汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居以及消费电子等各行各业。以公司重点发展的汽车电子领域为例，谈谈当前形势下我们看到的一些机会：

目前国内电动汽车市场发展迅速，但汽车芯片领域仍然由海外公司主导，智能座舱、车载音效等高端芯片更是几乎被海外公司垄断。瑞芯微经过多年布局，实现智能座舱、仪表中控、车载音频、车载视觉多产品线协同发展。

在汽车智能座舱领域，目前公司主推的 RK3588M 是国内少数能媲美国外一线产品的智能座舱 SoC 芯片，性能优异，一芯带多屏、端侧 AI 等能力突出，2024 年已量产车型十余款，超三十余款定点项目同步推进，在业内知名度持续提升；新产品 RK3576M 也正在进行客户导入，将进一步扩大公司产品在智能座舱的市场份额。

在车载音频领域，公司面对的竞品主要来自于海外公司，RK2118M 作为业界领先的集成 NPU 的汽车音频处理器，已成为众多主机厂、Tier1 与生态伙伴在汽车音频系统开发首选芯片平台，2024 年获得超过 20 个定点项目。

总体来看，公司依托技术、产品优势，客户认可度不断提升，在汽车电子多产品线已经取得快速发展，具备先发优势；相关国产化政策能够进一步打开国内厂商的市场空间，促进公司产品方案与各家车厂的合作，加速提升市场份额。

问题 4：贵公司自研 NPU 已支持 3B 参数级别模型部署，未来是否计划进一步提升算力以适配更大规模端侧模型？2025 年 NPU 技术迭代的重点方向是什么？

回复：公司自 2018 年推出第一代人工智能处理器 NPU 以来，经过持续迭代、不断推出多款内置 NPU 的 AIoT SoC 芯片，已形成内置 0.2TOPs 到 6TOPs NPU 算力的 AIoT SoC 完整布局，满足不同市场、不同水平的算力需求。后续还会推出更优性能、更高算力的芯片，助力 AI 大模型在端侧设备落地，尤其是协处理器平台，通过算力扩展不仅满足不同产品不同场景对更大规模端侧大模型的需求，也给成熟产品的算力升级、AI 赋能提供了可能，同时下一代旗舰芯片 RK3688，在人工智能应用上不仅提供 stronger 的性能更高的算力，同时多芯片级联和协处理器扩展都给更大规模端侧大模型的部署提供了更多的空间。

NPU 作为人工智能处理运算的最底层技术核心，公司紧跟 AIoT 产品算力快

速发展的趋势，将不断迭代 NPU IP，更强算力、更高效率地支持大模型推理。除了基础规格包括算子、精度等满足大模型效率的需求之外，我们还在多核众核和核间高速互联上不断优化设计架构，将细小的矢量运算和较大的运算矩阵相结合，极大的提高计算灵活度。总体上，我们在底层技术上不断优化、持续创新。

问题 5: 请问公司拓展海外市场的具体规划是什么？哪些地区的市场优先？公司哪些类型产品先出海？选择什么方式出海？

回复：目前公司 AIoT 的市场主要在国内。从 AIoT 产品和场景落地来看，国内发展比国外快，因为国内有场景优势、应用优势。瑞芯微以国内市场为起点，逐步实现 AIoT 全球布局。实际上，我们已经通过国内大量的终端客户、方案厂商、开源平台，实现全球布局。同时，我们积极参加海外各个大型行业展会，增进与海外代理商、方案商的配合，提升瑞芯微在海外市场的品牌影响力，为全球客户提供优质的产品与解决方案。

问题 6: 今年 1 月美国商务部工业和安全局再度收紧先进计算半导体的出口管制，并对台积电、三星、英特尔等晶圆代工厂的尽职调查，当前日趋复杂的国际经贸环境下，请问公司先进制程芯片是否会受影响？公司将如何应对持续升级的供应链安全挑战？

回复：瑞芯微的产品主要应用在边缘、端侧的 AIoT 百行百业。目前公司先进制程芯片基本没有受到影响。公司始终重视合规运营，已经建立了合规体系；我们也会持续关注相关风险，高度重视供应链安全，提前做一定的布局。

问题 7: 请问公司营收情况如何？

回复：公司 2024 年实现营业收入 31.36 亿元，同比增长 46.94%，创历史新高；实现净利润 5.95 亿元，同比增长 341.01%。2025 年第一季度，公司在 2024 年高增长的基础上，进一步实现营业收入 8.85 亿元，同比增长 62.95%；实现净利润 2.09 亿元，同比增长 209.65%。

问题 8: 请问公司的芯片跟美国的英伟达公司的差距和不同？

回复：公司 SoC 芯片主要应用于边缘侧、端侧的 AIoT 智能硬件，需要具备较强的综合性能和适当的通用性、兼容性，能够充分满足下游千行百业不同客户的差异化需求；而英伟达的高性能计算芯片主要应用于云端大模型的训练推理，二者产品定位、市场应用截然不同。

公司始终聚焦 AIoT 领域，在 AIoT 核心技术、算法、产品应用、场景方案

方面积累深厚，是国内 AIoT 产品线布局最丰富的厂商之一，拥有广泛的客户群体及生态伙伴，目前在 AIoT 多个场景中已有较高的市场份额。

问题 9：请问贵司协处理器、3688、3688M 预计具体什么时候推出，各主要指标参数分别是多少？

回复：公司计划于今年上半年推出协处理器芯片，进一步满足边缘侧、端侧设备的 AI 算力升级、运行大模型的需求。您可以关注公司后续官网及官方微信公众号发布的产品信息。2025 年公司将重点研发下一代先进制程旗舰芯片 RK3688，为开启公司新一轮成长周期奠定基础，该产品预计将于 2026 年推出。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的召开情况及具体内容，投资者可登陆上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，有关公司信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日